

贝格斯Hi-Flow 300P导热绝缘硅胶片

产品名称	贝格斯Hi-Flow 300P导热绝缘硅胶片
公司名称	东莞市樟木头松全电子材料经营部
价格	.00/pcs
规格参数	
公司地址	东莞樟木头镇东城四街
联系电话	86-076983819248-604 13712308769

产品详情

贝格斯bergquist hi-flow 300p 导热绝缘硅胶片

特点：

热阻0.13c-in²/w(25psi)

已被市场证明了的聚酰亚胺基材

卓越的绝缘性能

卓越的抗切割性能

应用：

弹片/扣具安装

独立的功率半导体和模块

规格：

厚度：0.102-0.127mm

增强承载物：聚酰亚胺

持续使用温度：150c

导热系数：1.6w/m-k

在cpu或功率元件和散热器之间作为导热界面，hi-flow

相变化材料是导热膏很好的替代物。材料在特定的相变化温度下从固态变成液态，可以来确保总的界面润湿，无溢出。与导热膏比较，它无脏污，污染和麻烦。